证券代码：300227 证券简称：光韵达

**深圳光韵达光电科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：DY2020-001

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  ☑其他 电话会议 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 太平洋证券：王凌涛、张方龙、吴毅、沈钱、杨海萍、黄福生，中天证券：张彤宇，中融基金：甘泉琦，中金公司：邱颖，长江证券：李静，幸福人寿保险：刘勇，兴业基金：廖欢欢、沈度，鑫源瑞资产：韦杨林，新意资本：魏茹，汐泰投资：董晗、何亚东、朱继刚、刘彦，沃胜资产：魏延军，万隆投资：文飞，顺时国际投资：朱碧琦，深圳银宏投资：王青涛，深圳熠星投资：陈天公，上投摩根基金：黄静、舒亮，瑞柏科技：李梅，仁桥资产：夏俊杰，仁桥资产：张鸿运，浦银安盛基金：郑爽超，朴禾投资：李鹏飞，平安银行：刘飞，科勤投资：刘振宇，锦江股份公司：陈杉，金信基金：江磊，汇丰晋信基金：候英杰，华夏久盈资产管理：王德彬、孟德鹏，华富基金：陈琦，华创证券：杨志瑞，红树林投资：李坚，豪盛(陕西)投资管理咨询有限公司：何朝阳，国泰租赁有限公司：王佳力，广发基金：罗阳，观富资产：万定山，共同基金：丁洋，方达信投资：高风通，东信资本：陈晨，成泉资本：张洛，常春藤资产：程熙云 （排名不分先后） |
| 时间 | 2020年2月24日 16:30-17:30 |
| 地点 | 电话会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长 侯若洪  董事会秘书 张洪宇 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1、董事长侯若洪先生介绍新型冠状病毒疫情复工情况：  原本公司1月份生产安排比较饱和，计划1月30日开始复工，但是受到了新冠疫情的影响，2月10日才开始陆续复工，截止目前返岗位比例大约70%；未能返岗的员工主要是湖北等重点疫区的人员，不能返回或者返回后正在隔离中。当前订单的需求较多，上游客户和供应商均存在员工未完全到岗不能完全运转的问题。公司内部预计3月上旬能够满产复工，公司将在二季度加紧生产和出货，把一季度耽误的时间和订单全部赶回来，力争全年不因疫情影响到整体业绩。  2、董事长侯若洪先生介绍全年发展方向：  （1）重点发展HDI钻孔业务：已将部分募集资金调整至HDI钻孔业务上，这是基于公司对5G发展带来HDI板需求大幅增长的预期，也基于公司在HDI上过去几年的深耕细作，在技术、生产效率上以及整个生产主线上都形成了自有、独特的优势，包括：在钻孔的技术上，形成了从芯片载板到类载板到HDI板这三种孔径钻孔能力，公司完成了从自动仓储到上下板到自动检测、加上激光钻孔这样一条完整的生产主线能力；在客户方面，公司春节年前与东山精密、悦虎电路签署了战略合作协议，未来双方在HDI板方面会加强合作，基于以上几点，公司未来几年会大力投入HDI的钻孔业务，使得它成为未来几年公司增长的重要支撑点。  3、董事长侯若洪先生介绍两个收购标的情况：  （1）金东唐：收购前本公司的业务主要是应用服务或精密制造服务，即用公司定制或开发的激光设备去给客户做精密的加工服务；收购金东唐后，业务拓展为从服务到解决方案，从检测设备到智能装备、生产检测一体化的智能生产线或生产设备都能提供。金东唐收购前主要做检测设备，主要客户是比如鹏鼎这种苹果系的电子模块生产厂家，收购以后，一方面扩展金东唐的客户，从苹果系电子模块扩展到面板、新能源电池等；另一方面扩展了产品类型，从检测设备到激光生产设备、生产检测一体化设备。金东唐三年的对赌业绩均已完成，2019年业务发展也比较好，公司对金东唐未来几年业绩的增长是非常有信心的，也会有新的发展规划。  （2）通宇航空：通宇航空去年第二季度收购并表，目前主要做的是飞机零部件以及加工为主的零部件，收购通宇航空主要是希望借助其军工的资质将公司3D打印技术用到航空上，这一块未来有较大市场需求。通宇业务发展良好， 3D打印业务公司也在积极地推进，公司将争取尽快拿到3D打印零部件的生产许可，这样通宇可以在原有业务的基础上开展新的零部件生产业务，进一步促进通宇的发展。  4、问答环节  Q1：1月份公告变更了部分定增的募集资金用途，今年在钻孔设备这块的扩产规模大概是多少？  答：今年公司第一期计划投50台激光钻孔设备，满足客户当前需求，后续客户产能扩张后，钻孔业务也会扩大需求；同时公司除了签署了框架协议的东山精密和悦虎电路外，其它客户也有此业务需求，公司会根据需要继续投资。  Q2：金东唐，特别是2015年收购它之后，前三年业绩里，做的比较多的是苹果相关检测业务，去年所开发的新业务，包括京东方10.5代线的检测业务以及未来宁德时代的锂电池封包相关的业务今年也要进来，这几块今年的成长增量情况？  答：京东方去年开始有业务，主要是LCD这块，今年可能会逐渐扩大业务，未来希望做到OLED，业务量、产品都能扩展，公司将努力做好业务。新能源电池方面，公司拥有从激光焊接到各种测试的完整自动化产线，具有较强的技术竞争力。未来客户对产线的需求会更多，因此这块业务是今后金东唐的重要增长点之一。  Q3：公司目前主要的三块优势业务都在扩张，从全公司角度来说，未来三年每年产能扩张节奏总体是什么比例？  A：不同的业务产能扩张不太一样。金东唐主要是以设备为主，嘉兴基地在去年逐步投入使用以后生产空间已经足够，未来的需求主要是产品开发和流动资金。HDI是公司资本投资扩张比较大的一块，将按照客户的需求来匹配。通宇未来可能在厂房和设备上会投入，包括3D打印的投入。  Q4：HDI厂自己也可以做通孔，但其与公司签订了框架协议，以公司协作为主，产生变化的主要原因是什么？  答：以往客户通常会自己生产大部分，高峰期会外发溢出产能给外协加工；但随着高阶HDI加工的孔径缩小、密度加大，对生产技术的要求也随之提升，加之公司近几年在技术上进步、生产效率上提升、以及研发的全自动化的钻孔生产线，公司的定位从外协加工提升为业务合作伙伴，并且客户从投入、效率、性价比等各方面对比后，引进合作伙伴是双赢的模式。  Q5：我们为多家客户做前道通孔，客户会不会担心被其他同行业竞争对手了解自己的设计或者其他工艺类的情况？  答：不会。首先公司新产线是自主研发，其次公司会在进驻到客户生产基地就近服务，由公司的人去管理和生产，同时公司有严格的保密制度和保密措施，确保公司及客户的技术信息不外泄。  Q6：今年是PCB激光钻孔的高景气周期，公司预计这轮景气度能持续多久？  答：个人认为应该可以持续3－5年。5G手机才刚开始出货，在未来几年逐步替代4G产品，除了手机外，外未来还有很多其他5G电子产品，会带来高阶HDI板需求，预计未来三到五年肯定是快速增长，之后可能会进入平稳发展阶段。 |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2020年2月24日 |